

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
【部門区分】第7部門第2区分
【発行日】令和6年12月4日(2024.12.4)

【国際公開番号】WO2023/190822
【出願番号】特願2024-512768(P2024-512768)

【国際特許分類】

H05K 3/42(2006.01)

H05K 3/46(2006.01)

【FI】

H05K 3/42 610C

H05K 3/46 N

H05K 3/46 B

10

【手続補正書】

【提出日】令和6年9月25日(2024.9.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

20

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1面および該第1面と反対側に位置する第2面を有する絶縁層と、
該絶縁層の前記第1面および前記第2面に開口を有するスルーホールと、
前記第1面の開口周囲から前記スルーホールの内壁面を介して前記第2面の開口周囲まで位置するスルーホール導体と、
該スルーホール導体に囲まれた領域に位置し、前記第1面側の第1表面および前記第2面側の第2表面の2つの表面を有する充填樹脂と、
を含み、

30

前記スルーホール導体は、第1スルーホール導体を含み、

該第1スルーホール導体は、前記スルーホールの少なくともいずれか一方の前記開口において、前記スルーホールの内側に延びる突出部を有しており、

断面視において、該突出部の前記充填樹脂と隣接する部分と前記充填樹脂の少なくとも前記第1表面または前記第2表面とのなす角が鈍角である、
配線基板。

【請求項2】

前記第1面に位置する前記スルーホール導体の表面、前記第1面側に位置する前記充填樹脂の前記第1表面、前記第2面に位置する前記スルーホール導体の表面、および前記第2面側に位置する前記充填樹脂の前記第2表面に、ランド用導体が位置している、請求項1に記載の配線基板。

40

【請求項3】

前記角が、100°以上160°以下である、請求項1または2に記載の配線基板。

【請求項4】

前記第1スルーホール導体に囲まれた前記充填樹脂の前記第1表面および前記第2表面の少なくともいずれか一方の幅が、前記スルーホールの幅の40%以上90%以下である、請求項1または2に記載の配線基板。

【請求項5】

前記絶縁層は、単位面積に占める前記スルーホールの開口面積の割合が第1占有率である第1領域と、単位面積に占める前記スルーホールの開口面積の割合が第2占有率である

50

第 2 領域とを含み、

前記第 2 占有率は、前記第 1 占有率よりも小さく、

前記第 1 スルーホール導体は、前記第 1 領域に位置している、

請求項 1 または 2 に記載の配線基板。

【請求項 6】

前記スルーホール導体は、第 2 スルーホール導体をさらに含み、

該第 2 スルーホール導体における前記スルーホールの内壁に位置する導体の厚みは、前記第 1 スルーホール導体における前記スルーホールの内壁に位置する導体の厚みよりも厚く、

前記第 2 スルーホール導体は、前記第 2 領域に位置している、請求項 5 に記載の配線基板。

10

【請求項 7】

前記第 2 スルーホール導体に囲まれた前記充填樹脂の前記第 1 表面および前記第 2 表面の幅が、前記第 1 スルーホール導体に囲まれた前記充填樹脂の前記第 1 表面および前記第 2 表面の幅よりも広い、請求項 6 に記載の配線基板。

20

30

40

50